

AT-HM02

厚膜银通孔浆料

产品介绍

AT-HM02 是一款用于厚膜多层布线通孔填充导体浆料，与银导体、过渡通孔有非常好的匹配性。同时与厚膜介质浆料有良好的相兼容。

产品特点

导电性好
与金、银导体匹配性好

典型性能

性能	指标
粘度 ¹ (Pa.s, 10 rpm, 25°C)	1000 - 3000
固含量 (%)	89.0 - 92.0
通孔分辨率 (um)	100
方阻 (mΩ/sq)	≤ 5
¹ Brookfield HBV 52Zcone	

推荐工艺

基板: AT-HM02性能是基于 96%氧化铝基板的测试。其他成分的基板和不同制造商的基板可能会导致性能属性的变化。

印刷: 推荐使用 325 目不锈钢丝网，乳胶厚度 20-25 μm。印刷速度 25 厘米/秒。印刷应该在清洁通风的环境中经行，在 20-23°C环境中印刷浆料具有最佳的印刷性能。

干燥: 浆料印刷后，在室温下流平 5-10 分钟，然后在通风的烘箱或传送带式干燥炉中 150°C干燥 10-15 分钟。

烧结: 烧结在具有通气的链式烧结炉中进行，使用 60 分钟周期烧结曲线，峰值温度 850 °C，10 分钟。

存储和有效期: 浆料应在密闭的容器中清洁、温度稳定的环境中保存，温度小于 25°C。在 没有打开容器的情况下，保质期为发货日期 6 个月。长时间存放可能会发生固体物沉降，使用前进行充分搅拌。

安全与处理: 本产品含有有机溶剂和材料，在使用AT-HM02时应采取以下预防措施：

在有足够通风的情况下使用；
避免长时间接触皮肤避免长时间吸入蒸汽；
如接触皮肤，应立即用肥皂和水清洗患处；
吞食有危险；